

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. August 2005 (04.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/072035 A1

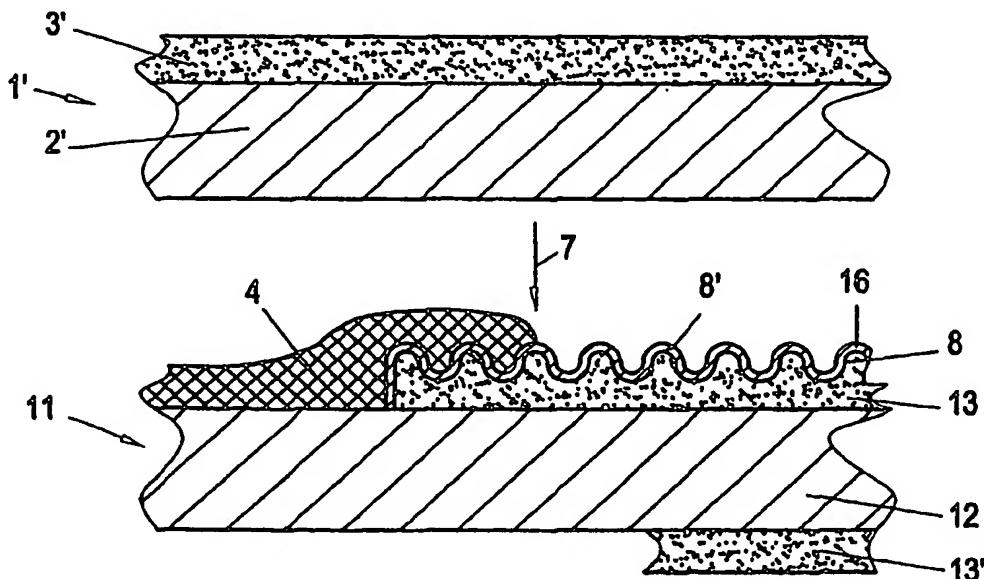
(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H05K 3/24, 1/16 (72) Erfinder; und
 (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT2005/000010 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUER, Wolfgang
 (22) Internationales Anmeldedatum: 21. Januar 2005 (21.01.2005) (AT)
 (25) Einreichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: SONN & PARTNER PATENTANWÄLTE;
 (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch Riemergasse 14, A-1010 Wien (AT).
 (30) Angaben zur Priorität:
 A 85/2004 23. Januar 2004 (23.01.2004) AT (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
 jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
 AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
 CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
 FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
 KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
 MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
 PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
 TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
 ZW.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(54) Titel: METHOD FOR THE PRODUCTION OF A CIRCUIT BOARD ELEMENT AND CIRCUIT BOARD ELEMENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES LETTERPLATTELEMENTS SOWIE LETTERPLATTELEMENT

WO 2005/072035 A1



(57) Abstract: A circuit board element (11) and production thereof are disclosed, whereby a noble metal (16) is applied to a structured conductor layer (13) on a circuit board substrate (12), comprising said conductor layer (13). The conductor layer (13) is roughened on the surface, preferably after the structuring thereof and the noble metal applied as a layer (16), essentially on all of the structured roughened conductor layer (13), whereupon the noble metal layer surface is given a corresponding roughness (8).

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)